

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2026-058

债券代码：123252 债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

关于 2026 年度第一期中期票据（科技创新债）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第五届董事会第二十二次会议、2026年3月30日召开公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于拟注册发行中期票据（科技创新债券）的议案》，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，拟以银邦金属复合材料股份有限公司为发行主体，发行额度预计不超过4亿元的中期票据（科技创新债券）。

近日，公司已完成2026年度第一期中期票据（科技创新债券）的发行，现将发行结果公告如下：

债券名称	银邦金属复合材料股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	债券简称	26 银邦金属 MTN001(科创债)
债券代码	102683232	期限	2 年
起息日	2026 年 8 月 21 日	兑付日	2028 年 8 月 21 日
计划发行总额	1 亿元	实际发行总额	1 亿元
发行利率	2.40%	发行价格	100 元/百元面值
簿记管理人	上海银行股份有限公司		
主承销商	上海银行股份有限公司		
联席主承销商	/		

公司本次中期票据发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com.cn）。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日